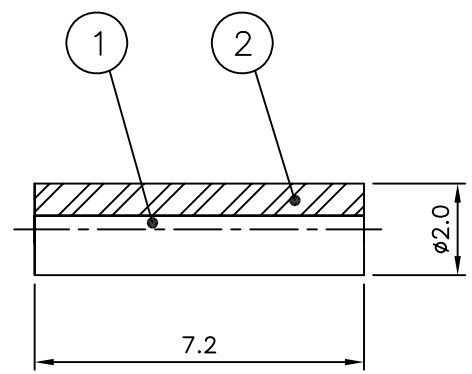


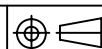
REVISION				
REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
IR	Initial Registration	S.Y.EUN	I.C.KIM	2018.01.18.



* 조립 후 검사 주의사항

- PIN과 절연체 조립 후 PIN 양끝단이 절연체 보다 돌출되지 않도록 주의 할 것.
- PIN+절연체 조립시 헐겁지 않게 관리 필요.
(발주 진행 시 PIN 한도 견본을 절연체 외주 가공업체에 전달하여
조립 후 길이나 절연체가 헐겁지 않게 관리 될 수 있도록 내용 전달 필요.)

2	INSULATOR	1	TEFLON		DIN02927-N/1
1	CONTACT	1	MBsBD C3604BD-F	Gold Plate	DCT03914-5/1
NO.	DESCRIPTION	Q'TY	MATERIAL	PLATING	CODE

TOLERANCE	Decimal	DATE 2018. 01. 18.			 KJ COMTECH CO.,LTD.	RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017	
	Angle	APPROVED BY	I.C.KIM				
MATERIAL	_____	CHECKED BY	TITLE BUSHING				
		DRAWN BY					
FINISH	_____	SCALE 6/1	UNIT mm		A4	DWG NO.	CN03759-7/1
						REVISION	I R